

证券代码：920125

证券简称：鸿仕达

公告编号：2026-103

昆山鸿仕达智能科技有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

√ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

√ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 8 月 18 日

活动地点：昆山鸿仕达智能科技有限公司会议室

参会单位及人员：招商证券、浙商证券、光大资管、喜世润投资、融通基金、永赢基金、柏乔投资、混沌投资、明诚基金、中晨晟嘉、西部证券、寰宸投资、滦海资本、淳厚基金、诚师控股、歌汝资本、博时基金、五中投资、国联民生、珞州私募、国盛证券

上市公司接待人员：董事长胡海东先生、董事会秘书单兴洲先生、证券事务代表韦淑霞女士

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：公司半年度报告中显示毛利率同比上升 8.23 个百分点，变动的原因是什么？

回答：2026 年上半年，公司综合毛利率提升至 34.36%，同比上升 8.23 个百分点，主要系收入结构优化及各业务板块盈利水平改善。受益 AI 硬件、先进封装行业景气上行，高毛利半导体业务实现高速增长，收入同比增长 421.44%，毛利率达到 52.43%，较上年同期提升 21.54 个百分点。AI 服务器自动化设备、先进封装设备等高附加值产品实现批量交付，显著拉动整体盈利水平。同时，消费电子板块项目质量持续改善，毛利率同比提升 6.86 个百分点，为综合毛利率上行提供有力支撑。

问题 2：公司未来的发展战略会聚焦在哪些方向？

回答：公司将坚持“消费电子稳固基本盘、泛半导体长期突破”的发展战略。稳固消费电子业务，保障现金流基本盘；紧抓 AI 服务器自动化设备、先进封装设备行业机遇，把泛半导体作为核心增长引擎，做强植散热片机、AI 服务器自动化设备，依托新设子公司布局半导体前道量测设备，推进国产替代。

加大精密运动控制、机器视觉、工业软件等核心技术研发投入，提升产品精度与软硬件一体化能力。依托泰国、新加坡子公司推进海外本地化布局，拓展全球客户，同时完善募投项目建设，强化供应链管理，对冲行业周期波动，实现高质量增长。

问题 3：请简单介绍 SOCAMM、TIM2 二款设备，为什么是 AI 服务器 L6 制程关键设备，两款设备工艺价值以及后续有无迭代升级规划？

回答：SOCAMM 内存封装设备、TIM2 服务器散热点胶设备，是适配 AI 服务器主板集成与裸机测试环节的配套自动化装备，现已实现对中国台湾客户批量出货。L6 是高端 AI 服务器生产中主板集成的关键工序，该平台架构复杂，传统组装难以满足精度要求，必须依靠高精密的自动化设备完成生产。SOCAMM 封装设备完成 SOCAMM 内存模组高精度压接组装，TIM2 设备实现服务器散热界面材料精密点胶，二者直接影响整机组装良率，具备不可替代的工艺价值。公司将紧跟

AI 服务器硬件迭代节奏，针对新一代硬件需求持续迭代设备版本，优化设备兼容性、生产节拍与良率表现，同步推进不同客户的导入验证。

问题 4：公司的竞争优势体现在哪些方面？

回答：公司深耕智能自动化装备赛道，竞争优势集中在技术、产品、下游布局、客户资源多方面。

一是技术层面，公司掌握精密机构设计、机器视觉、精密运动控制等多项核心技术，形成综合技术体系，可针对客户需求开展“主动研发”加“需求响应式研发”，模块化开发提升迭代效率；二是产品端，泛半导体领域优势突出，植散热片机、SOCAMM 服务器内存封装设备、TIM2 散热点胶设备，适配 AI 算力服务器先进封装制程，部分设备实现独家批量供货，决定高端 AI 服务器生产良率，具备不可替代的工艺价值，泛半导体业务毛利率达 52.43%；三是下游布局上，业务覆盖消费电子、泛半导体、新能源三大高景气赛道，收入结构持续优化，对冲单一行业周期波动；四是客户资源方面，长期服务纬创资通、立讯精密和鹏鼎控股等行业头部客户，同时积极拓展海外市场，泰国、新加坡子公司支撑海外业务落地。

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日